

2011年(平成23年)9月26日(月曜日)

日刊



発行所 電波新聞社

東京本社 東京都品川区東五反田1-11-15 千141-8715 03(3445)6111(大代表)

大阪本社 大阪市中央区北浜3-2-25 (京阪淀屋橋ビル6階) 千541-0041 06(6203)3361(大代表)

西部本社 福岡市博多区博多駅前2-13-23(扇寿ビル) 千812-0011 092(431)7411(大代表)

©電波新聞社 2006

千住金属工業

千住金属工業は、微小パッケージ用フリップチップ向けに、機能性に優れたマイクロボールや、転写用はんだシートPPSを展示した。C4はんだバンパやT

フリップ用 転写用はんだシートなど展示

SV積層などの接合技術として、はんだ材料を提供する。パッケージ内の接続はマイクロボール搭載方式は落として込みボール供給が主流であり、真球度が高く粉径の小さなはんだボール

セミコン台湾2011

注目日系材料企業

③

Sとは、接着剤が塗布されているフィルム表面に膜乳 M EMSなどの次世代実装法で製造した微小はんだにも対応可能である。



奥野支社長④とスタッフ一同

粉末を高密度に付着させた転写シート。PPSは、凸凹な基板表面にもはんだを転写できる。任意な形状のバンパ形成や微小な部品の実装にも応用できる。千住金属工業は、先端領域の半導体実装に独自の接合技術と高機能な材料を提供することで台湾の半導体産業に貢献する。

(おわり)
(猪狩前特派員)